



ABM, Inc.
Photolithographic Products

ABM高精度半自动紫外掩膜光刻机系统

(具备双面可视以及软件自动对位/人工手动对位功能)

型号: ABM/8/NUV/DCCCD/BSV/SA-AA



主要配置:

- ▶ 有效范围8英寸紫外掩膜光刻机
可针对8/6/4/2英寸基片和碎片进行双面光刻作业
- ▶ 采用高精度紫外LED作为光源，具有光源稳定，波长切换快速便捷，使用寿命长，免维护，绿色环保等诸多优点
- ▶ 光路系统采用高精度消衍射及微透镜光学系统，具备高分辨率和大景深曝光模式，可制备最细0.8微米线宽的图形（1微米胶厚，1:1等间距图形）
- ▶ 具有硬接触，软接触，接近式和真空4种曝光模式
- ▶ 卡盘具备全自动非接触式芯片厚度补偿系统
- ▶ 紫外波长350nm-450nm
- ▶ 大景深光刻聚焦对准，景深可达400 微米
- ▶ 光强和均匀性：
输出光强10%-100%范围内调节
最优光强值
30mw/cm²@365nm 65 mw/cm²@405nm
光强不均匀性优于+/-2.5%
- ▶ 高精度正面背面可视对准系统：
正面对准精度+/-0.5微米，背面对准精度+/-1.0微米
- ▶ 配备高精度图形化界面可根据用户需要实现
软件自动识别标记对位和人工手动对位套刻两种功能
- ▶ 系统具备键合预对准升级扩展的能力
- ▶ 机械调节分辨率0.01 μm
角度调节分辨率+/-0.00001°
X/Y 总行程范围+/-5 mm
Theta总行程: +/-5°

